



Title of Change:	Qualification of Additional Assembly at site Hana, Ayutthaya Thailand for TSOP6 products.	
Proposed first ship date:	18 June 2019	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <marty.paul@onsemi.com >	
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < MohdAzizi.Azman@onsemi.com >	
Type of notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Change Part Identification:	As material from different assembly sites cannot be combined into (1) reel, product from Hana will show ASSY LOC: HN (ASSY LOC = Assembly Location Code) on the label of the reel and box. In addition, the ASSY IN: field will change FROM: SEREMBAN TO: THAILAND Please see sample MPN on page 2 at the following link http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LABELRM-D.PDF to see the location of the ASSY LOC and ASSY IN identifier. In addition, each individual part has a 6 digit part marking form: XXXA (YW) The "A" stands for the Assembly site. All new material will be marked with an "H" in the A position. For an example, see below in the Description and Purpose section.	
Change Category:	☐ Wafer Fab Change ☒ Assembly Change ☐ Test Change ☐ Other _____	
Change Sub-Category(s):	☒ Manufacturing Site Addition ☐ Manufacturing Site Transfer ☐ Manufacturing Process Change ☒ Material Change ☐ Product specific change ☐ Datasheet/Product Doc change ☐ Shipping/Packaging/Marking ☐ Other: _____	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: None	External Foundry/Subcon Sites: Hana Thailand

**Description and Purpose:**

This is an FPCN to notify customers that ON Semiconductor has begun qualification of TSOP6 packages at the Hana, Ayutthaya Thailand location for the ONC25 products listed in this announcement in order to increase capacity. Assembly will be qualified.

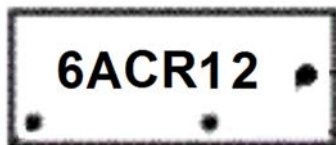
As a result, the following changes will occur for product built in Hana only:

Material Change	Existing Material	Hana site Material
Leadframe	Selective AG 38x64 mils	PPF+ME2 40X72 mils
Die Attach	EN4370K3	Ablebond 8006NS
Mold Compound	G600FB	EMEG633CA

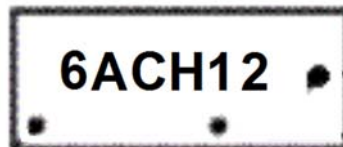
Marking change	Existing Material	Hana site Material
	Fourth character in marking is "R".	Fourth character in marking is "H".

Marking example:

An NCP4306DADZZDASNT1G built in Seremban:



An NCP4306DADZZDASNT1G built in Hana:

**Reliability Data Summary:**

QV DEVICE NAME: NCP4306
RMS 53259,54632
PACKAGE TSOP6

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs	0/240
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/240
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc	0/240
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/240
AC	JESD22-A102	121°C, 100% RH, 15psig, unbiased	96 hrs	0/135
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/615
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/45



QV DEVICE NAME: NCP1360

RMS 46046

PACKAGE TSOP6

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/240
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc	0/240
AC	JESD22-A118	121°C, 100% RH, 15psig, unbiased	96 hrs	0/240
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/480
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/45

QV DEVICE NAME: NCP12510

RMS 46075

PACKAGE TSOP6

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/240
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc	0/240
AC	JESD22-A118	121°C, 100% RH, 15psig, unbiased	96 hrs	0/240
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 3 @ 260 °C		0/480
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/45

Electrical Characteristic Summary: Electrical characteristics are not impacted**List of Affected Parts:**

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
NCP12510ASN100T1G	NCP4306DADZZDASNT1G
NCP12510ASN65T1G	NCP4306DADZZDASNT1G
NCP12510BSN100T1G	NCP4306DADZZDASNT1G
NCP12510BSN65T1G	NCP4306DADZZDASNT1G
NCL30073SN065T1G	NCP4306DADZZDASNT1G
NCP4306DADZZDASNT1G	NCP4306DADZZDASNT1G
NCP4306DAHZZAASNT1G	NCP4306DADZZDASNT1G
NCP4353BSNT1G	NCP4306DADZZDASNT1G
NCP1251FSN65T1G	NCP4306DADZZDASNT1G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22227X

発行日 : 11 March 2019

変更件名:	TSOP6 製品の組立て拠点として HANA (タイ、アユタヤ) の追加認定	
初回出荷予定日:	18 June 2019	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <marty.paul@onsemi.com> にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。	
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または <MohdAzizi.Azman@onsemi.com> にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> 宛てにお願いします。	
変更部品の識別:	両製造拠点の製品を 1 つのリールに混在することなく、HANA 品のリールおよび箱に貼られるラベル上の Assembly Location Code は ASSY LOC:HN と表示されます。さらに、同ラベル上の ASSY IN: フィールドは SEREMBAN から THAILAND に変わります。 ASSY LOC および ASSY IN の配置については次のリンクにある冊子の 2 ページ目のサンプル MPN ラベルを参照してください。 http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LABELRM-D.PDF さらに、各製品には 6 桁のマーキング様式: XXXA (YW) が使われます。「A」は組み立て拠点を表します。すべての新しい製品 (HANA 品) の A の位置には「H」が表示されます。表示例については、以下の「説明および目的」の項を参照してください。	
変更カテゴリ:	☐ ウェハファブの変更 ☒ アセンブリの変更 ☐ 試験の変更 ☐ その他 _____	
変更サブカテゴリ:	☒ 製造拠点の追加 ☒ 材料の変更 ☐ データシート/製品資料の変更 ☐ 製造拠点の移転 ☐ 製品仕様の変更 ☐ 出荷/パッケージング/表記 ☐ 製造プロセスの変更 ☐ その他: _____	
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: なし	外部製造工場 / 下請業者拠点: HANA (タイ)



説明および目的:

この IPCN は、オン・セミコンダクターが本通知に記載した ONC25 製品の生産能力を拡大するために、HANA (アユタヤ、タイ) での TSOP6 パッケージの認定を開始したことをお客様に通知するものです。組立てが認定されます。

結果として、HANA で製造される製品には、次の変更が行われます。

材料の変更	変更前の表記	変更後の表記
リードフレーム	Selective AG 38x64 mils	PPF+ME2 40X72 mils
ダイアタッチ	EN4370K3	Ablebond 8006NS
モールドコンパウンド	G600FB	EMEG633CA

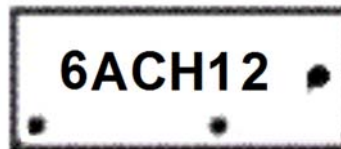
表示変更	変更前の表記	変更後の表記
	表示の 4 番目の文字は「R」です。	表示の 4 番目の文字は「H」です。

表示例:

セレンバンで製造される NCP4306DADZZDASNT1G :



HANA で製造される NCP4306DADZZDASNT1G :



信頼性データの要約:

デバイス名: NCP4306

RMS 53259,54632

パッケージ: TSOP6

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs	0/240
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/240
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc	0/240
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/240
AC	JESD22-A102	121°C, 100% RH, 15psig, unbiased	96 hrs	0/135
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/615
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/45



デバイス名: NCP1360

RMS 46046

パッケージ: TSOP6

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/240
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc	0/240
AC	JESD22-A118	121°C, 100% RH, 15psig, unbiased	96 hrs	0/240
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/480
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/45

デバイス名: NCP12510

RMS 46075

パッケージ: TSOP6

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/240
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc	0/240
AC	JESD22-A118	121°C, 100% RH, 15psig, unbiased	96 hrs	0/240
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 3 @ 260 °C		0/480
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/45

電気的特性の要約: 電気的特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
NCP12510ASN100T1G	NCP4306DADZZDASNT1G
NCP12510ASN65T1G	NCP4306DADZZDASNT1G
NCP12510BSN100T1G	NCP4306DADZZDASNT1G
NCP12510BSN65T1G	NCP4306DADZZDASNT1G
NCL30073SN065T1G	NCP4306DADZZDASNT1G
NCP4306DADZZDASNT1G	NCP4306DADZZDASNT1G
NCP4306DAHZZAASNT1G	NCP4306DADZZDASNT1G
NCP4353BSNT1G	NCP4306DADZZDASNT1G
NCP1251FSN65T1G	NCP4306DADZZDASNT1G